

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局



(43) 国際公開日
2005 年 9 月 22 日 (22.09.2005)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2005/088711 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01L 23/36, G02F 1/1345, H05K 1/02

(21) 国際出願番号: PCT/JP2005/004349

(22) 国際出願日: 2005 年 3 月 11 日 (11.03.2005)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願2004-074285 2004 年 3 月 16 日 (16.03.2004) JP

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 松下電
器産業株式会社 (MATSUSHITA ELECTRIC INDUS-
TRIAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5718501 大阪府門真市大
字門真 1 0 0 6 番地 Osaka (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 福迫 浩
幸 (FUKUSAKO, Hiroyuki). 瀬野 和 徳 (SENO,
Kazunori).

(74) 代理人: 特許業務法人池内・佐藤アンドパートナ
ーズ (IKEUCHI SATO & PARTNER PATENT ATTOR-
NEYS); 〒5306026 大阪府大阪市北区天満橋 1 丁目
8 番 3 0 号 O A P タワー 2 6 階 Osaka (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が
可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR,
BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM,
DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU,
ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS,
LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA,
NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE,
SG, SK, SL, SM, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG,
US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.

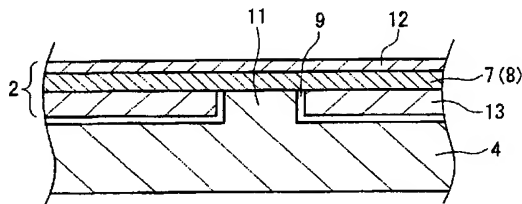
(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護
が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA,
SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ,
BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE,
BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU,
IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR),
OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML,
MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:
— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される
各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語
のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: DRIVER MODULE STRUCTURE

(54) 発明の名称: ドライバモジュール構造



(57) Abstract: Disclosed is a driver module structure comprising a flex-
ible substrate (2) provided with a wiring pattern (7), a semiconductor de-
vice mounted on the flexible substrate (2), and a conductive heat-dissi-
pating body (4) joined to the semiconductor device. The wiring pattern
(7) includes a ground wiring pattern (8), and the flexible substrate (2) is
provided with a hole (9) through which a part of the ground wiring pattern
(8) is exposed. The exposed ground wiring pattern (8) and the heat-dis-
sipating body (4) are electrically connected through a member (11) fitted
in the hole (9).

(57) 要約: 配線パターン (7) が形成されたフレキシブル基板 (2) と、フレキシブル基板 (2) に搭載された
半導体装置と、半導体装置に接合された導電性の放熱体 (4) とを備えたドライバモジュール構造であって、配
線パターン (7) はグラウンドの配線パターン (8) を含んでおり、フレキシブル基板 (2) に、グラウンドの配線パ
ターン (8) の一部を露出させた孔 (9) が形成されており、孔 (9) に嵌合した部材 (11) を介して、露出し
たグラウンドの配線パターン (8) と放熱体 (4) とが導通するように接続されている。

WO 2005/088711 A1